



2014年1月20日

## 最新发布

### **AKROMETRIX宣布推出CXP(对流可扩展平台) - 经济型高温表面特性分析**

高温表面特性技术的领导者Akrometrix, LLC，宣布推出了实用的CXP -对流可扩展平台 - 结合了软件平台Studio的最新表面量测设备。CXP回应了EMS和PCB市场对PCB特定区域在回流焊环境下，表面分析的平价技术需求。CXP工具作为一款PCB表面贴装区域的翘曲量测设备而言，是EMS和PCB公司一款实惠的解决方案，可满足最新的IPC 9641标准。

Akrometrix通过测试服务以及多种机型，测量了各类贴装在PCB前的封装产品，为电子工业服务超过20年。当这已经成为产品良率和可靠性关键参考时，相对应的PCB结合面翘曲却还没有被完全的理解。最近定案推出的IPC9641工业标准，将PCB贴装区域的翘曲测量的重要性，首次推倒了前线。

根据Akrometrix销售和业务发展部副总裁 Mr. David Markovich 所说：“CXP是在乔治亚理工学院的云纹投影技术专利基础上研发出来，它相比Shadow Moiré 在成本方面有一些独特的优势，同时提供了适当的测量分辨率。考虑到在EMS和PCB工业的竞争利润，Akrometrix 现在为这些公司提供了一种能满足IPC 9641标准并具经济效益的解决方案。”

使用CXP系统收集到的PCB结合面翘曲结果，可以继续使用Akrometrix的Interface Analysis分析软件来与相对应的封装产品的翘曲数据做结合，由此可以在回流焊过程中的关键性温度下进行形状匹配和互连间隙分析。

CXP系统的推介代表了Akrometrix持续向满足和超过客户的方向提供解决方案的承诺。CXP现在已经可以在全球销售。

Akrometrix， LLC是高温表面特性的领导者，由Dr. Charles Ume在1993年成立。他是乔治亚州首府亚特兰大，乔治亚理工学院乔治·伍德拉夫机械工程学院先进电子封装和镭射加工实验室的主管及教授。Akrometrix全球范围安装有超过250台的设备，总部位于亚特兰大。